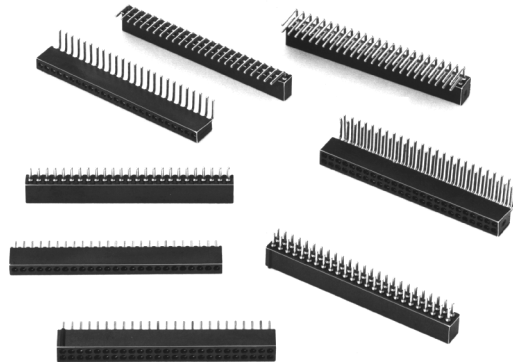


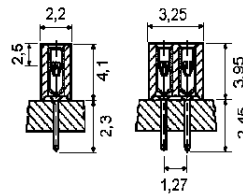
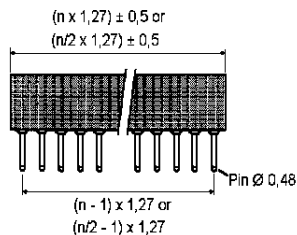
#### Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
	Feder: 3 Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: Screw Machined Brass
	Clip: 3 Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktfläche	lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3-2,5 µm)
Contact Surface	acc. to options (see below), over Ni (1,3-2,5 µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 10 mOhm
Contact Resistance	≤ 10 mOhm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>10</sup> Ohm
Insulation Resistance	> 10 <sup>10</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit	1000 V <sub>RMS</sub>
Test Voltage	1000 V <sub>RMS</sub>
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-55°C...+125°C
Temperature Range	-55°C...+125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-Soldering, further informations in chapter T

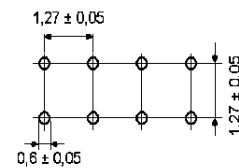
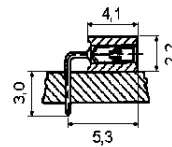
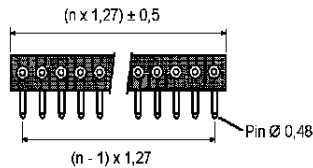
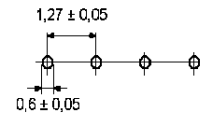


© W+P PRODUCTS

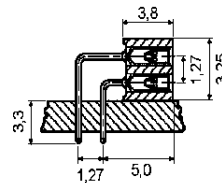
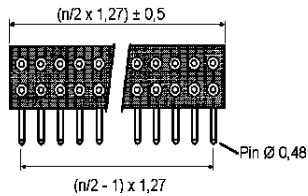
Einsetzbar für Rundstift Ø 0,4 - 0,48 mm  
 Passende Stiftleisten Serie: 355  
 Accepts Round Pin Ø 0,4 - 0,48 mm  
 Mates with Pin Headers Series: 355



#### PCB-Layout



n = Anzahl Kontakte  
 n = No. of Contacts



Series	Type*	Contacts*	Sleeve Plating	Clip Plating
155	10	002	50	30
	10 = einreihig, gerade <i>single row, straight</i> 20 = zweireihig, gerade <i>double row, straight</i> 11 = einreihig, gewinkelt <i>single row, right angled</i> 21 = zweireihig, gewinkelt <i>double row, right angled</i>	002-050-pol. einreihig <i>single row</i> 004-100-pol. zweireihig <i>double row</i>	50 = Hülse verzinnt <i>sleeve tin plated</i>	10 = Feder 0,25 µm Gold <i>0,25 µm gold plated</i> 30 = Feder 0,75 µm Gold <i>0,75 µm gold plated</i>

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* Order example - To be replaced by your specifications.)

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T